

Description du produit

FINITION: CETTE PLATINE SERA IMMERSION GOLD PLATED SELON IPC-6012.
L'ÉPAISSEUR EST DE 0.505MM SUR LE NICKEL DE 3 à 6uM.

PLAQUETTE DE CUIVRE HOLS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES FAISCEAUX NE PEUVENT PAS ÊTRE
PLUGÉS

Pack avec un film incolore transparent à bulles, 25 PCS / sac, mettre un déshydratant dans un flanc, placer
une carte indicateur d'humidité sur le dessus

Structure de couche

L1 ----- HOZ

- PP 7mil -

--

L2 ----- 1OZ

- CORE 9.05mil -

L3 ----- 1OZ

--

- PP 7mil -

L4 ----- HOZ

Définitions de la couche:

* .GCMT - Masque de revêtement supérieur

* .GTP - Top Solder Paste

* .GTO - Sérigraphie supérieure

* .GTS - Top Soldermask

* .GTL - Top Layer

* .G2L - Inner Signal Layer 1

=====
* .G3L - Inner Signal Layer 2

* .GBL - couche inférieure

* .GBS - Bottom Soldermask

* .GBO - Sérigraphie en bas

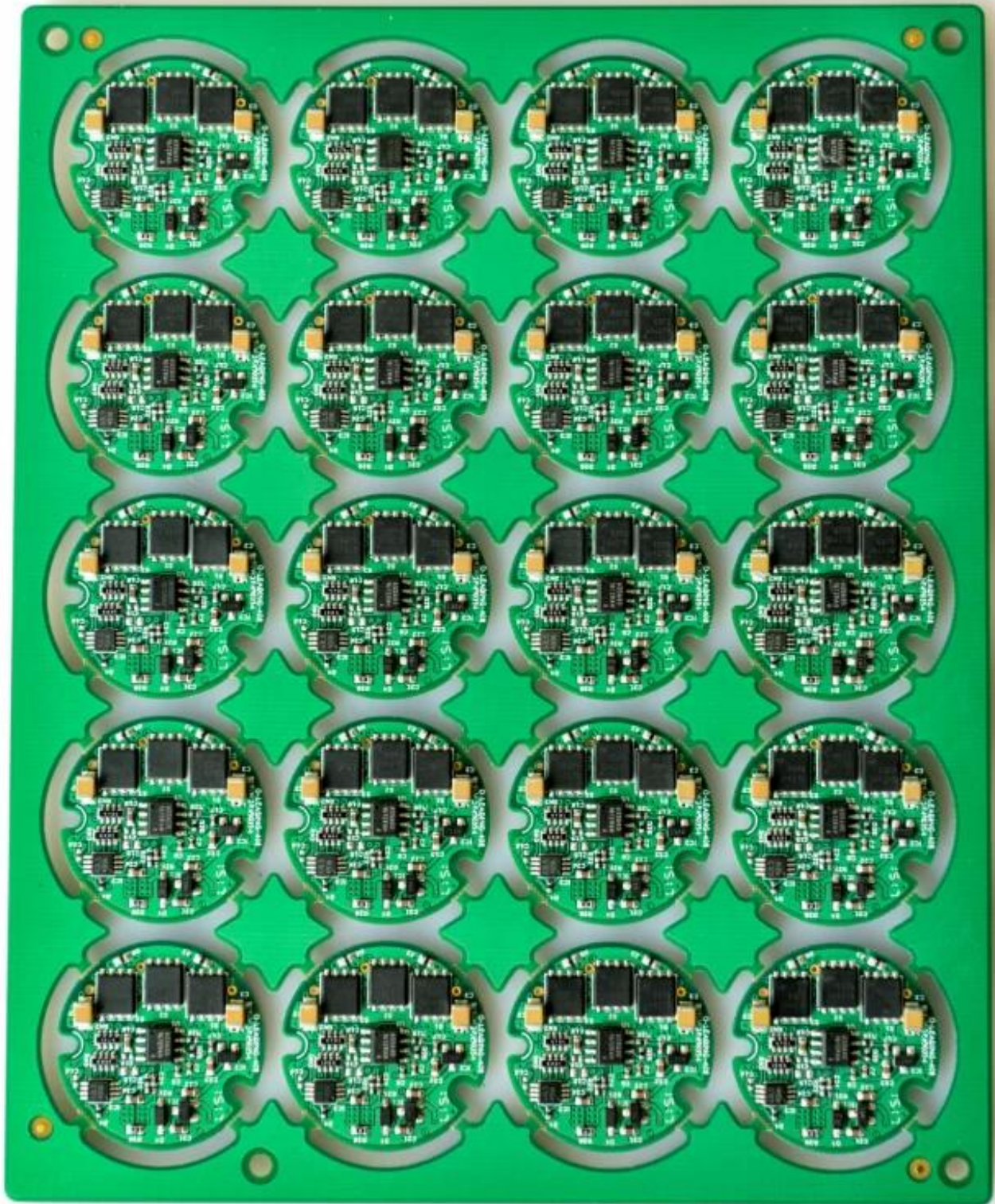
* .GBP - Pâte à souder inférieure

* .GCMB - Masque de revêtement conforme au bas









[Fournisseur de carte de circuit imprimé, design Pcb en Chine](#)